

รายงานประกอบการศึกษารายวิชา ENE311 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การออกแบบวงจร buck converter

สมาชิกในกลุ่ม

65070502406 นายกิตติภพ พันธะชาติ65070502424 นายนพมินทร์ พิรวัชรไพศาล65070502427 นางสาวนิรชา โพธิ์พ่วง

นำเสนอ

ดร.รวิวุฒิ ขุนอินทร์

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บันทึกปฏิบัติการการบัดกรีวงจรบนบอร์ด PCB

ให้นักศึกษาลงบันทึก วัน และเวลา ตั้งแต่การออกแบบใน KiCad ไปจนถึงการทดสอบวัดผล โดยระยะเวลาการทำงาน ทั้งหมด รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

วันที่	เวลาเริ่ม	ระยะเวลา (ชั่วโมง)	รายละเอียด
21 ก.ย.	20:00	2	วางแผนและประชุมแนวทางการออกแบบ PCB
22 ก.ย.	20:00	3	ทำการออกแบบวงจรใน KiCad และลองรันบน LTSpice
9 ต.ค.	8:30	1	ลิสต์รายการอุปกรณ์ที่ต้องซื้อ
14 ต.ค.	13:00	2	ซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามลิสต์
25 ต.ค.	13:00	2	บัดกรีวงจรทั้งหมด
31 ต.ค.	13:00	1	ทำการทดสอบและบันทึกผล

1. คุณลักษณะของวงจร buck converter

Buck Converter เป็นวงจรแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC Converter) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อลด แรงดันไฟฟ้าขาเข้าให้ต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าขาออก โดยวงจรนี้ใช้การควบคุมสวิตช์ความถี่สูงผ่าน MOSFET เพื่อจัดการ การไหลของกระแสไฟฟ้าและพลังงาน การทำงานนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ แรงดันไฟฟ้าต่ำและเสถียร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาและระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

ส่วนประกอบสำคัญในวงจร Buck Converter ประกอบด้วย MOSFET ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิด วงจร โดยมี Gating Block เป็นตัวสร้างสัญญาณ PWM เพื่อควบคุมสถานะการทำงานของ MOSFET ตัวเก็บประจุ (Capacitor) และตัวเหนี่ยวนำ (Inductor) เป็นอุปกรณ์จัดการพลังงานที่ช่วยลดความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าและทำ ให้กระแสไฟฟ้าไหลต่อเนื่อง นอกจากนี้ ไดโอดยังช่วยป้องกันกระแสย้อนกลับและให้กระแสไหลในทิศทางเดียวเมื่อ MOSFET ปิด

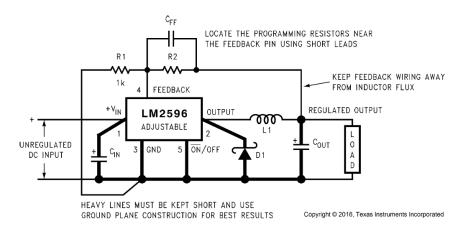
การทำงานของวงจรแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่ ช่วงที่ MOSFET เปิด (Switch ON) และช่วงที่ MOSFET ปิด (Switch OFF) ในช่วงที่ MOSFET เปิด กระแสไฟจากแหล่งจ่ายจะไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ ซึ่งสะสมพลังงานในรูปของ สนามแม่เหล็ก และจ่ายกระแสไปยังโหลด ในทางกลับกัน เมื่อ MOSFET ปิด ตัวเหนี่ยวนำจะปล่อยพลังงานที่สะสมไว้ ผ่านไดโอดไปยังโหลด กระบวนการนี้ทำให้เกิดการไหลของกระแสอย่างต่อเนื่องโดยแรงดันไฟฟ้าขาออกจะถูกปรับให้ เรียบด้วยตัวเก็บประจุ

กระบวนการแปลงแรงดันใน Buck Converter เริ่มจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ส่งกระแสไฟผ่านการควบคุมของ
MOSFET โดยมีตัวเหนี่ยวนำและไดโอดทำหน้าที่จ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่องถึงโหลดแม้ในช่วงที่ MOSFET ปิด ตัวเก็บ
ประจุช่วยกรองแรงดันไฟฟ้าขาออกให้เรียบและนิ่ง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือแรงดันไฟฟ้าขาออกที่ต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
และมีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน

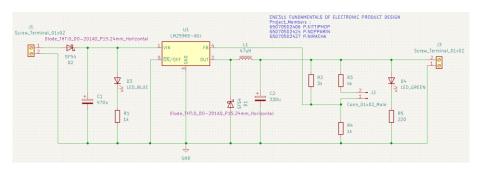
Buck Converter เป็นวงจรแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่มีความสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมี ประสิทธิภาพสูงและตอบโจทย์การใช้งานในระบบที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าต่ำและมีเสถียรภาพ วงจรนี้อาศัยการควบคุม การเปิด-ปิดของ MOSFET ร่วมกับการจัดการพลังงานในตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่มี คุณภาพสูงและเหมาะสมต่อการใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ

2. การออกแบบวงจรใน KiCad

2.1 ออกแบบวงจรตาม Datasheet ของ LM2596s : ในการบวนการนี้เราจะต่อวงจรตาม
Datasheet ที่กำหนดโดยหลักการทำงานของวงจรจะขึ้นอยู่กับแรงดันที่เข้าขา Feedback ซึ่งสามารถ
คำนวนได้จากสมการที่อยู่ใน Datasheet



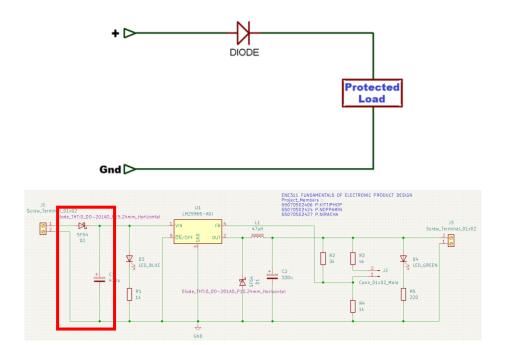
รูปที่ 1 LM2596 จาก Datasheet



รูปที่ 2 LTSpice ของวงจร

2.2 ออกแบบสำหรับเพิ่มจุดเด่นของวงจร LM2596s

2.2.1 Voltage polarity protection: ในการออกแบบ Voltage polarity protection เราจะใช้ Diode ที่มีความสามารถนำกระแสได้ทิศทางเดียวทำให้เราสามารถนำคุณสมบัตินี้ในการมาใช้ เพื่อป้องกันการต่อไฟฟ้ากลับขั่วของผู้ใช้งาน



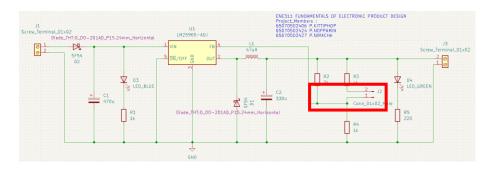
รูปที่ 3 Voltage polarity protection (จุดเด่นของวงจร)

2.2.2 Voltage Selection by Jumper : เราจะใช้หลักการเหมือนกับการกดสวิชต์ใน การควบคุมแรงดันขาออกของวงจร โดยจะมีเงื่อนไขคือ

J2 - Short : Vout = 3.3V

J2 - Open : Vout = 5V

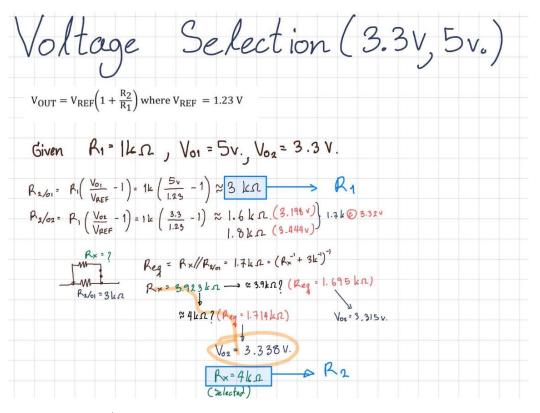
ในการเพิ่มหลักการนี้จะเหมาะสำหรับการเป็นแหล่งจากให้กับระบบฝั่งตัว (Embedded System) ที่มีแรงดันใช้งานส่วนใหญ่ มีค่าเท่ากับ 3.3V และ 5V



รูปที่ 4 Voltage Selection by Jumper

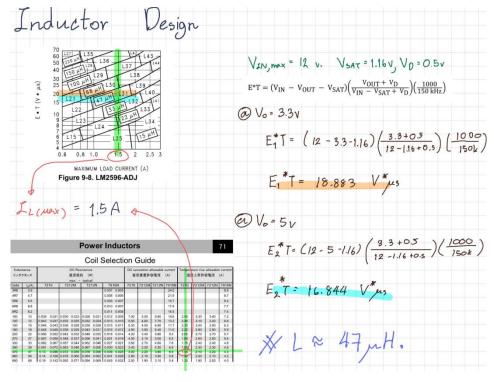
2.3 คำนวนพารามิเตอร์ของวงจร LM2596s

ผลการคำนวณค่าความต้านทานของ Voltage Selection จาก ข้อ 2.2.2



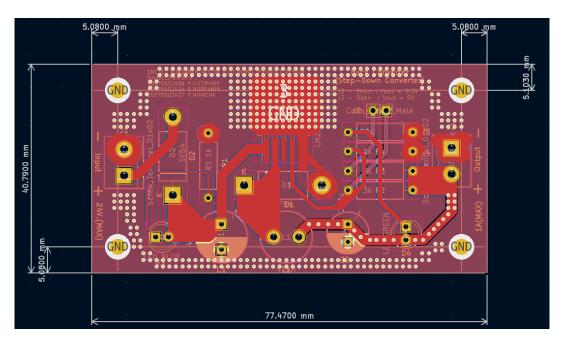
รูปที่ 5 ผลการคำนวณค่าความต้านทานของ Voltage Selection

ผลการคำนวณค่าความเหนี่ยวนำ(L)

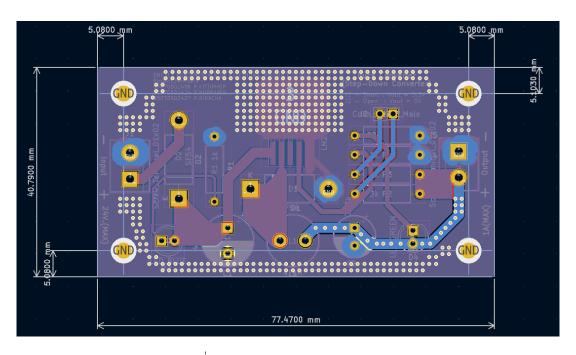


รูปที่ 6 ผลการคำนวณค่าความความเหนี่ยวนำ (L)

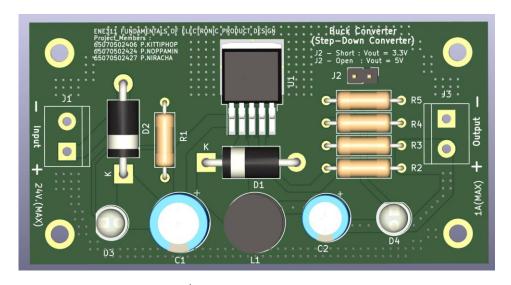
2.4 ผลการออกแบบ PCB ของวงจร LM2596s-Adj



รูปที่ 7 ผลการแบบ PCB (Top Layer)

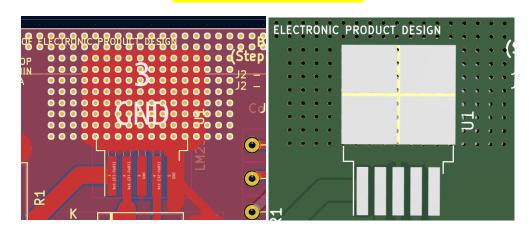


รูปที่ 8 ผลการแบบ PCB (Bottom Layer)



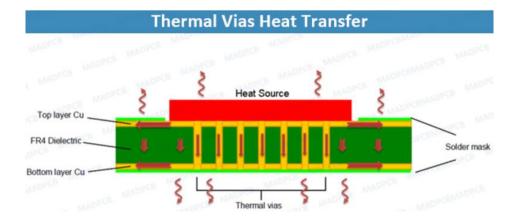
รูปที่ 9 ผลการแบบ PCB (3D View)

Design Techniques



รูปที่ 10 Design Techniques

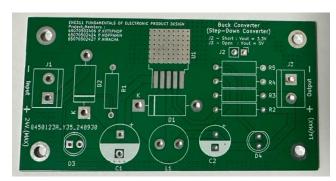
ในวงจรแปลงแรงดันไฟฟ้ามักเกิดพลังงานสูญเสียที่เป็นไปตามกระแสไฟฟ้า โดยพลังงานสูญเสียที่เกิดขึ้น จะ เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ทำให้จึงต้องใช้เทคนิค Thermal Vias ที่จะส่งความร้อนผ่านรูโลหะ (Via) จึงทำให้ระบายความร้อนได้ไวและ เพิ่มอายุการใช้งาน

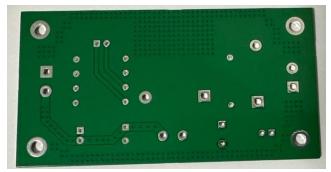


รูปที่ 11 Thermal Vias Heat Transfer

3. การตรวจทานและทดสอบความถูกต้อง

บอร์ด PCB ที่กลุ่มของคณะทำงานได้ทำการออกแบบในโปรแกรม Kicad และได้ทำการทดลองรันค่าต่าง ๆ ใน โปรกแรม LTSpice



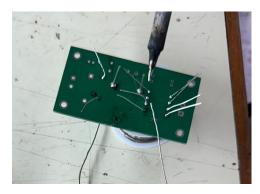


รูปที่ 12 PCB เริ่มต้นที่ได้ทำการออกแบบมา

วิธีหรือแนวทางที่กลุ่มของคณะทำงานได้ทำคือเราจะทำการบัดกรีอุปกรณ์ที่เล็กไปใหญ่ โดยวิธีคือเอาหัวแร้ง แตะที่ขาของอุปกรณ์ที่เราต้องการบัดกรีและให้เติมตะกั่วลงไปในจุดที่เราต้องการเชื่อมต่อ ในขั้นตอนนี้อาจจะต้องระวัง ในการใช้งานเนื่องจากหัวแร้งมีความร้อนสูง อาจทำให้บอร์ด PCB เกิดการเสียหายได้ เมื่อทำการบัดกรีเสร็จแล้วทำ ความสะอาดและเช็คว่ามีตรงส่วนไหนที่เราทำการบัดกรีผิดพลาดหรือไม่

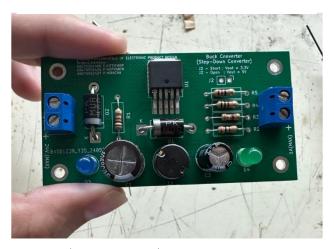


รูปที่ 13 อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการบัดกรี





รูปที่ 14 ทำการบัดกรี



รูปที่ 15 บอร์ด PCB ที่ทำการบัดกรีเสร็จสมบูรณ์

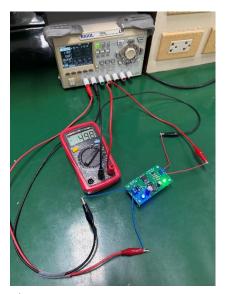
ปัญหาต่างๆ ที่พบเจอตลอดกระบวนการบัดกรีวงจร

ในขั้นตอนการบัดกรีนั้นพบปัญหาคือ :

- ในขั้นตอนการบัดกรีนั้นพบปัญหาคือ การที่เชื่อมจุดบัดกรีไม่ติดเนื่องจากบริเวณนั้นมีความสกปรกกลุ่ม ของคณะทำงานจึงใช้นำยาฟลักซ์เพื่อเช็ดทำความสะอาด และทำการบัดกรีต่อ
- เนื่องจากหัวแร้งมีความร้อนสูงจึงทำตะกั่วละลายเยอะมากเกินไป และการที่เราใช้ตะกั่วมากเกินไป ทำให้ จุดบัดกรีไม่สวย กลุ่มของคณะทำงานจึงทำการบัดกรีจุดนั้นใหม่ โดยใช้ที่ดูดดูดตะกั่วส่วนเกินออก

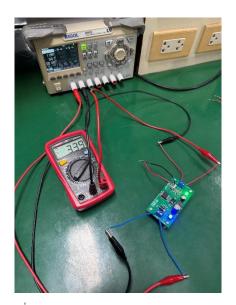
ขั้นตอนการทดสอบและบันทึกค่าต่าง ๆ

ทำการวัดค่า Output ของวงจรว่าได้ตามการคำนวณหรือไม่ โดยเราจะกำหนด Input เป็น 12V และ ใช้ Multimeter ในการวัดในครั้งนี้



รูปที่ 16 ทำการวัดค่า Output (Open-Circuit)

จากรูปที่ 16 เราได้ทำการวัดว่า Output แบบ Open-Circuit ทำการวัดค่าออกมาได้ 4.98V



รูปที่ 17 ทำการวัดค่า Output (Short-Circuit)

จากรูปที่ 17 เราได้ทำการวัดว่า Input แบบ Short-Circuit ทำการวัดค่าออกมาได้ 3.39V

4. สรุปผลการทำงาน

การออกแบบวงจร LM2596s- Adj. มีความยากในการจำลองการทำงานเนื่องจาก ไม่มี Spice – Model ในการ ทำ Simulation ดังนั้นในการออกแบบ จำเป็นต้องออกแบบตาม Datasheet โดยการออกแบบความต้านทานสามารถ แทนค่าสมการได้อย่างสะดวกแต่สำหรับการเลือกค่าความเหนี่ยวนำต้องอาศัยการใช้หลักการ Look up Table ในการ เลือกค่าความเหนี่ยวนำ โดยจะมีข้อจำกัดจากกระแสของตัวเหนี่ยวนำที่เลือกมา , <u>สำหรับการออกแบบ PCB</u> ในขั้นตอน แรงจะเป็นการวาง Layout โดยจะแบ่งส่วนที่ LM2596s-adj เป็นส่วนที่มีความร้อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ Thermal Vias Technique ซึ่งจะทำให้มีการระบายความร้อนได้ดีและเพิ่มอายุการใช้งานของวงจร , ในการออกแบบจุดเด่น (Features)ของวงจร คือ

Voltage polarity protection : ช่วยให้ป้องกันการกลับขั้วของแหล่งจ่าบ

Voltage Selection by Jumper : ช่วยในการประยุกต์ใช้งานกับระบบฝั่งตัว(Embedded System)

นอกจากในการออกแบบจุดเด่นของวงจร,ยังมีขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์ที่ทุกอุปกรณ์ถูกอ้างอิงจาก Electronic Source ทำให้ในกระบวนการประกอบและบัดกรีวงจร ไม่มีปัญหา แต่ในขั้นตอนนี้มีความยากลำบากในการบัดกรี สำหรับอุปกรณ์ SMD เพราะ LM2596s จะมีพื้นที่ผิวการระบายความร้อนเยอะทำให้การบัดกรีต้องใช้เวลานานในการ บัดกรีให้ที่พื้นที่ผิวติดกับ PCB

<u>กระบวนการทดสอบ</u>วงจรพบว่า วงจรทำงานเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ แต่ยังมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เป็น เนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทาน 5% เมื่อใช้ในระบบจะมีความคลาดเคลื่อนสะสมจนทำให้แรงดันที ออกมามีความคลาดเคลื่อนจากที่ออกแบบจริงไปเล็กน้อย